

DR型樹脂包封固體電解質鉭電容器

溫度特性 Temperature characteristics

表 II table2

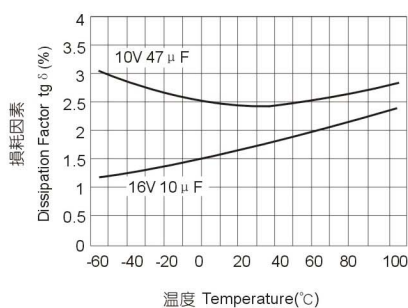
容量 Capacitance (uF)	容量變化 (%) Capacitance Change			損耗最大值 (%) DF Max				漏電流最大值(μ F) DCL Max		
	-55℃	+85℃	+125℃	-55℃	+20℃	+85℃	+125℃	+20℃	+85℃	+125℃
≤1.0				6	4	6	6	10I ₀	12.5I ₀	
1.5~6.8	±10	±15	±25	8	6	8	8			
10~68				10	8	10	10			
100~680				12	10	12	12			

表 III table3

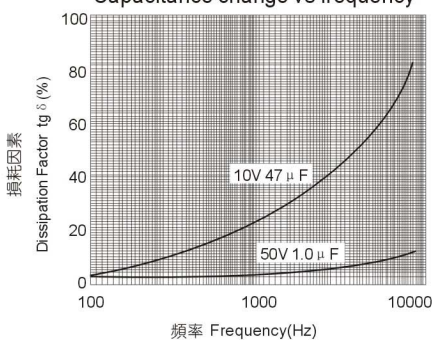
尺寸型號 Case Size	D (max)	H (max)	h (±0.5mm)	d (±0.5mm)
A	4.5	7.5	2.5	0.5
B	5.0	8.5	2.5	0.5
C	5.5	9.5	2.5	0.5
D	6.5	11.0	2.5	0.5
E	8.5	13.0	5.0	0.5
F	9.5	16.5	5.0	0.5

特性曲線 Typical Characteristic Curve

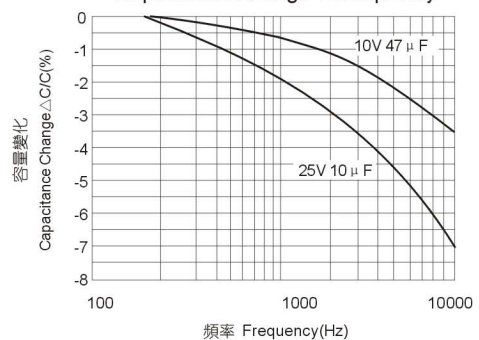
損耗因素 — 溫度曲線
Dissipation factor vs temperature



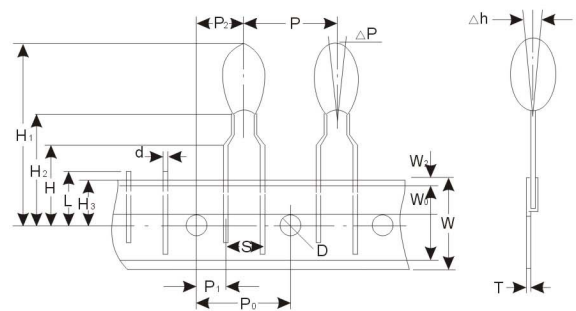
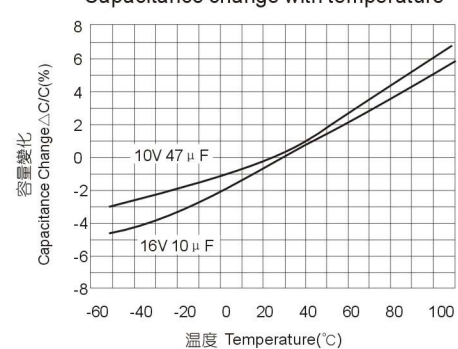
容量變化 — 頻率曲線
Capacitance change vs frequency



容量變化 — 頻率曲線
Capacitance change vs frequency



容量變化 — 溫度曲線
Capacitance change with temperature



名稱 Designation	符號 Symbol	尺寸 Dimensions(mm)
元件間距 Pitch of component	P	12.7±1.0
給進孔間距 Feed hole pitch	P0	12.7±0.3
紙帶寬度 Tape width	W	18+1 -0.5
粘膠帶寬度 Hold down tape width	W0	10±2.0
給進孔位置 Hold position	H3	9+0.75 -0.5
粘膠帶位置 Hold down tape position	W2	3.0max
元件頂部到給進孔心距離 Overall component height	H1	32.5max
元件偏差 Component alignment	△P	±1.3max
給進孔直徑 Feed hole diameter	D	4.0±0.2
紙帶厚度 Tape thickness	T	0.5±0.2
元件偏差 Component alignment	△h	±2.0max
引線切屑長度 Length of snipped leads	L	11max
引線腳切腳高度 Lead clinch height	H	16±0.5
引線腳間距 Lead wire spacing	S	2.5±0.5 5.0±0.7
給進孔中心至引線腳間距 Feed hole center to wire center	P1	5.10±0.5 3.85±0.7
給進孔中心至元件中心間距 Hole center to component center	P2	6.35±0.4
元件引線根部到給進孔心間距 Component height	H2	18+2 -0
引線直徑 Lead diameter	d	0.5±0.1